



## Tagesordnung

Thema: 72. Treffen des Arbeitskreises  
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und  
Verbindungstechnologien“

Datum: **3. Mai 2021, 10.00 Uhr**

Ort: Fraunhofer IZM, Berlin  
Online via MS Teams

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

### Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr  
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 2 10:10 Uhr  
Wellenhöhenmessung  
*Herr Neiser, SEHO Systems GmbH, Kreuzwertheim*
- 3 10:50 Uhr  
Metall-Keramik-Substrate & Silbersintern von Metall-Keramik-Substraten  
*Herr Dr. Schwöbel, Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Hanau*
- 4 11:30 Uhr  
Gedruckte Elektronik: Technologien, Anwendungen und Herausforderungen  
*Frau Neermann, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg*
- 5 12:10 Uhr  
Mittagspause
- 6 13:10 Uhr  
Mechanische Werkstoffcharakterisierung an dünnen Filmen  
*Herr Dr. Walter, Fraunhofer IZM, Berlin*

- 7 13:50 Uhr  
Die 5 häufigsten Fehler in der Baugruppenfertigung und ihre sichere Erkennung  
*Herr Kokott, Göpel electronic GmbH, Jena*
- 8 14:30 Uhr  
Kaffeepause
- 9 15:00 Uhr  
MLCC Zuverlässigkeit  
*Herr Dr. Leib, Fraunhofer IISB, Erlangen*
- 10 15:40 Uhr  
Leiterplattenoberflächen – Retrospektive mit Ausblick  
*Herr Schmidt, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 11 16:20 Uhr  
Abschlussdiskussion  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*

**Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr**